**苏州国芯科技股份有限公司**

**2023年12月4日-6日投资者关系活动记录表**

**证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2023-025**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 高毅资产；融通基金；宝盈基金；大成基金；中信建投证券；德邦证券；开源证券；财通证券；东吴证券自营；大朴资产；农银汇理；东方睿石。 |
| **时间** | 2023年12月4日15：002023年12月6日13：302023年12月6日15：00 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司参加人员姓名** | 董事会秘书：黄涛先生；证券事务代表：龚小刚先生； |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。****1、我们注意到公司近期成功申请了一项名为“同一声学空间交流增强语音信号的处理方法、装置及介质”的发明专利，可否请介绍一下？**答：本专利公开了一种同一声学空间交流增强语音信号的处理方法、装置及介质，应用于神经网络、本地扩声技术领域。本方法先获取麦克风原始信号以及扬声器参考信号，然后根据扬声器参考信号所含的频率成分得到估计反馈信号，并根据麦克风原始信号以及估计反馈信号得到带噪信号。之后根据神经网络模型所需的特征对估计反馈信号以及带噪信号进行特征提取，最后将提取的特征输入神经网络模型以得到目标语音信号，并由扬声器进行播放。本申请通过训练模型来处理麦克风原始信号，能够同时识别稳态及非稳态噪声，提高去噪能力。同时通过扬声器参考信号得到估计反馈信号以及带噪信号，从而解决扬声器非线性失真及系统啸叫问题，进而提高语音交流的效果。**2、公司近期在不断参加各类汽车电子的展会或交流会，可否介绍一下？**答：公司在MCU、SoC和数模混合芯片等车用核心芯片系列方面覆盖面较全，截至目前公司已在汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用SoC芯片、线控底盘芯片、仪表芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等12条产品线上实现系列化布局，客户群体比较多。为实现公司汽车电子业务做大做强，公司在不断推出不同系列产品的基础上，持续加强汽车电子业务的市场开拓工作，不断提升公司的汽车电子品牌影响力，使得更多的客户了解国芯的汽车电子技术和产品，近期公司先后参加了AUTO TECH 2023 华南展、2023汽车芯片产业大会、2023中国汽车产业发展（泰达）国际论坛等活动（相关活动信息可以持续关注国芯科技的公众号），进一步推进了更多客户了解国芯科技，国芯科技的汽车电子品牌影响力进一步扩大。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年12月 |